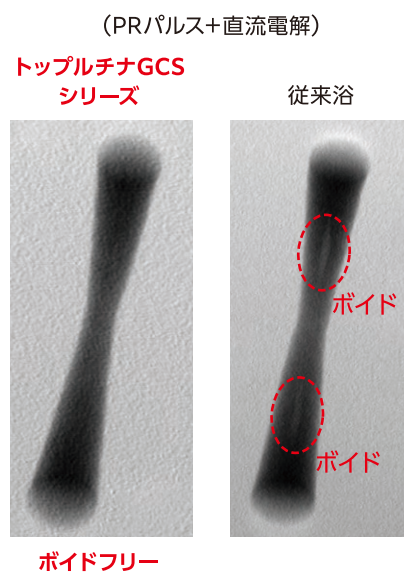
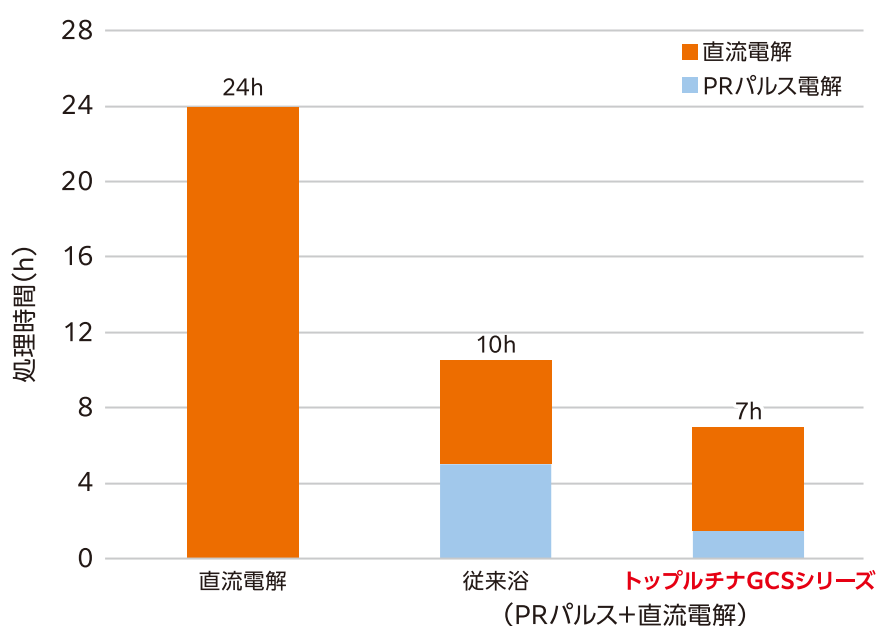


トップルチナGCSシリーズ

- 寸法安定性に優れるガラスコア基板にめっきが可能
- PRパルス電解(トップルチナGCS PR)と直流電解(トップルチナGCS TF)の併用により、短時間でスルーホールフィリングを実現

ボイドフリーかつ高速でスルーホールフィリングを実現

板厚800 μ m, 穴径80 μ m基板のスルーホールフィリングに必要なめっき時間

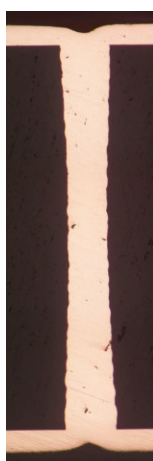


PRパルス電解(トップルチナGCS PR)と直流電解(トップルチナGCS TF)の併用により、電解時間の大幅な短縮とボイドフリーを実現

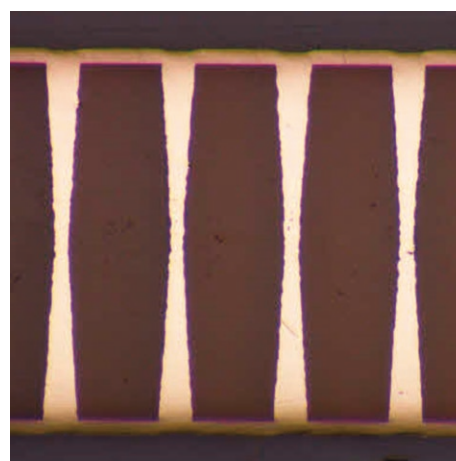
高アスペクト比スルーホールに対応



板厚 500 μ m
穴径 50 μ m



板厚 800 μ m
穴径 100 μ m



板厚 800 μ m, 穴径 80 μ m